

DuPont™ MPF

Microlithographic Polymer Film

バンパ形成に最適の厚膜フォトレジスト、3次元半導体パッケージ用超高解像度フォトレジスト、及びハウジング用永久レジストをご提案します。

バンパ形成用レジスト：WBシリーズ

WB Series photoresist for bump forming

製品群

WB5000シリーズ

- 半導体パッケージ基板バンパ用
- 25、30、38 μ m

WBR2000シリーズ

- 半導体ウエハ (FC-BGA/WL-CSP) バンパ用
- 50、75、100、120 μ m厚

特長

優れた耐熱性と密着性

- 鉛フリーはんだ対応
- 320 $^{\circ}$ Cリフローで剥がれ無し

優れた剥離性

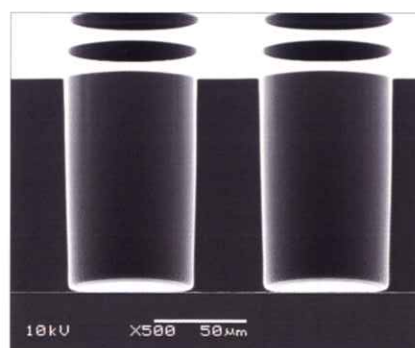
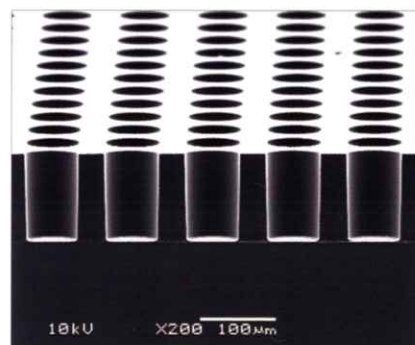
- リフロー後剥離で残渣無し
- 短時間で溶解剥離が可能

優れたバンパホール形状

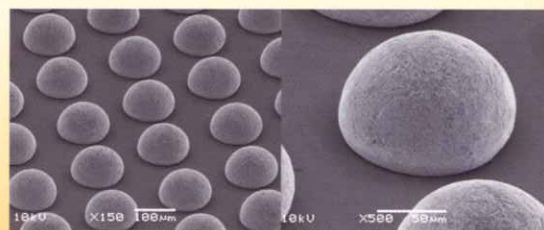
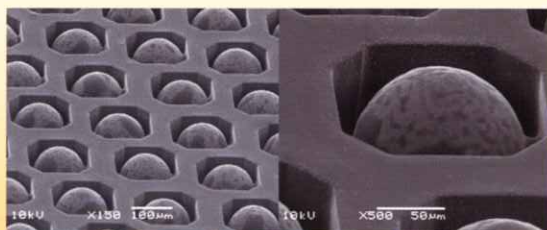
- 均一な形状
- はんだ印刷量の管理が容易

優れた膜厚均一性

- フィルム状レジスト
- 25、30、38、50、75、100、120 μ m厚



WBR2120 (120 μ m厚)でのファインピッチ断面形状 (現像後)
ピッチ100 μ m、ホール径75 μ m



WBR2075 (75 μ m厚) はんだリフロー後の良好な密着性とクリーンな剥離性

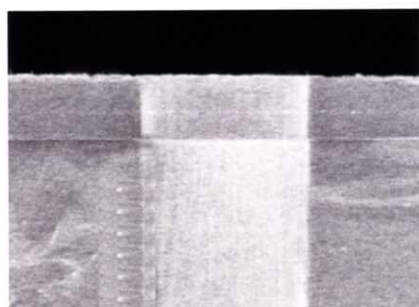
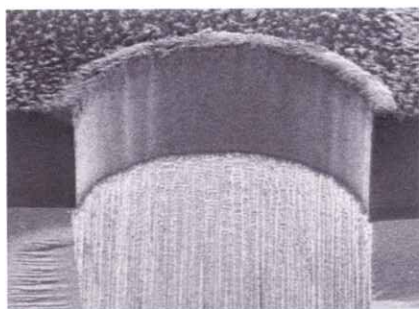
DMCF

3次元半導体パッケージ用ドライフィルム：MX 及び PerMXシリーズ Dryfilm photoresist for 3D-TSV application

TSV (Through Silicon Via:シリコン貫通ビア) 構造を持つ3次元半導体パッケージ構造におけるビア形成用ドライフィルム及び感光性ドライフィルム永久レジストを提案いたします。

ドライエッチングマスク用ドライフィルム
MX5000シリーズ

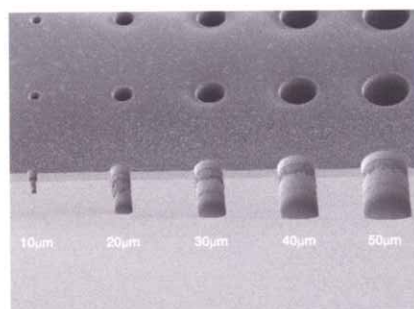
- ボッシュプロセスに対応した耐ドライエッチング性
- Via充填メッキに対応したメッキ特性
- テンテイング性
→ 液状レジストコーティングによるビア底汚染なし



Courtesy of RTI International

ファインライン形成用ドライフィルム
MXA100シリーズ

- 次世代の貫通Via径対応の優れた解像性



感光性ドライフィルム永久レジスト PerMX3000シリーズ

- イメージセンサ SAW フィルタ等のハウジング
- ガラス-シリコン、シリコン-シリコンボンディングに対応
- 優れた耐薬品性 (有機溶剤/酸/アルカリ溶液)

